

2026 年 3 月 18 日

各 位

会 社 名 ニデック株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 岸田 光哉
取 引 所 東証プライム（6594）
所 在 地 京都市南区久世殿城町 338
問合先 コーポレートコミュニケーション部長 渡邊 啓太
電 話 (075) 935-6150

当社子会社の SEMICON China 2026 への出展について

当社グループ会社であるニデックアドバンステクノロジー株式会社及びニデックインスツルメンツ株式会社は、3 月 25 日(水)～3 月 27 日(金)に上海新国際博覧中心で開催される「SEMICON China 2026」に出展いたします。

2026 年 3 月 18 日

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和
所 在 地 京都府向日市ニデックパーク 33 番地 C 棟

SEMICON China 2026 への出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2026 年 3 月 25 日（水）～3 月 27 日（金）に中国・上海の上海新国際博覧中心で開催される「SEMICON China 2026」に出展します。



本展示会は、設計から製造、パッケージング、設備、材料に至るまで、半導体産業の全工程を網羅する 1,000 社以上の企業が集結し、4,500 超のブースが展開される中国最大規模の展示会です。

当社ブースでは、半導体ウェハ検査を支える光学式外観検査装置やプローブカードに加え、新規開発した「MLO 基板（Multilayer Organic Substrate）」を中国で初めて展示いたします。同基板は、配線密度の飛躍的な向上と高速信号伝送の両立を実現しており、微細化が進む半導体検査工程において高い注目を集めています。

また、今回はグループ会社のニデックインストルメンツ株式会社と共同出展し、同社の高度なウェハ搬送ロボットと当社の検査技術を融合させ、半導体製造工程における最先端の検査・搬送トータルソリューションを世界に向けて発信してまいります。

〈出展概要〉

- ・会期：2026 年 3 月 25 日（水）～27 日（金）
- ・会場：上海新国際博覧中心
- ・ブース：E6713
- ・公式サイト：<https://www.semiconchina.org/>

〈主な展示内容〉

- ・3D/2D/SD ウェハバンプ検査装置 RWi-300MK3
- ・大型基板対応 3D/AFVI+AI 検査装置 AURCA シリーズ
- ・ウェハおよび PLP 向け 2D+3D 検査装置 AURCA-S シリーズ
- ・TGV 向け高精度 2D/3D 検査ソリューション
- ・パワー半導体向け Front-End/Back-End 検査ソリューション
- ・プローブカード用 MLO 基板 ・半導体ウェハ検査用プローブカード ・半導体ウェハ用搬送ロボット